

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2023-156

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开第四届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2023年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过31.7亿元人民币；其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币6亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-070）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：

#### 二、担保进展情况

为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与中国银行股份有限公司

司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“中国银行”）签订编号为“2023年保字第626号”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精测于保证额度有效期内向中国银行发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、担保合同的主要内容

#### （一）《最高额保证合同》（编号：2023年保字第626号）

- 1、债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
- 2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
- 3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
- 4、保证额度有效期自2023年12月20日起至2024年3月2日
- 5、被担保最高债权额：人民币伍仟万元整
- 6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：本合同项下所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

### 四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为89,881.48万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至2022年12月31日净资产的27.87%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

### 五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日